

Prosave™**RC****Heat Resistant (150°C)
For High Temperature****耐熱 150°C
熱のかかる工程に**

Heat resistant adhesive layer, for optimum protection
And reinforcement in processes involving heat.
Low adhesive residue after heating for easy peeling.
Stable peel strength even during heating.
Choose THS for short-term,
high temperature usage and SHR for longer-term uses.
SHR prevents oligomer precipitation and maintains
its transparency even after heating.
Anti-static substrate surface.

Main Use

- Protection for hard-coat film
- Backing film when printing conductive paste
- Protection for screen printing
- For copper foil carrier
- Protection in other processes using heat

粘着層が耐熱のため、熱処理工程での
保護材・補強材に最適です。
加熱後の糊残りも少なく、再剥離が容易です。
加熱時も安定した粘着力が持続します。
高温下短時間の使用には THS を、
長時間の使用には SHR をお選びください。
SHR はオリゴマー析出を防止し、
加熱後も透明性を維持します。
基材表面は帯電防止処理加工。

主な用途

- ハードコートフィルムの保護として
- 導電ペースト印刷時の裏打ちフィルムとして
- シルク印刷時の保護として
- 銅箔キャリア用として
- その他熱のかかる工程の保護として

**Structure
構造****THS**

Anti Statics	帯電防止層
Base Material	基材
Heat Resistant PSA	耐熱粘着層
Release Liner	セパレーター

SHRAnti Static /
Prevent Precipitation of Oligomer

●——帯電防止・オリゴマー析出防止層	
Base Material	基材
Heat Resistant PSA	耐熱粘着層
Release Liner	セパレーター

**Thickness
厚み [μm]**

		THS	SHR	
Base Film	基材	25	25	50
Adhesive Layer	粘着層	2.5	10	10
Release Liner	セパレーター	25	25	25

**Adhesive Property
粘着特性****Initial Strength**

初期粘着力 [N/25mm]

	PET	Glass	Acrylic	SUS
THS	0.072	0.06	0.085	0.035
SHR	0.1	0.08		0.07

**Antistatic Performance
帯電防止性****Surface Resistivity**表面抵抗率 (AS性) [$\Omega/\square$]

	2.8×10^9
	1.6×10^{10}

Heat Resistance

耐熱性 [150°C]

Adhesive transfer and no adhesion failure from adherend weren't noticed, even when heating Up to 150°C.
(THS/30min SHR/360min)

150°Cで過熱後も糊残りや被着体からの浮きがほとんどありません
(THSで30分、SHRは6時間後まで)

150°C・30min. Peel strength after heating

150°C・30分加熱後の粘着力

		Peel Strength 粘着力 [N/25mm]	Adhesive Transfer 糊残り	Adhesion Failure 被着体からの浮き
THS	PET	0.1	none	none
	Glass	0.11	none	none
	SUS	0.09	none	none

150°C・6hr. Peel strength after heating

150°C・6時間加熱後の粘着力

		Peel Strength 粘着力 [N/25mm]	Adhesive Transfer 糊残り	Adhesion Failure 被着体からの浮き
SHR	PET	0.33	none	none
	Glass	0.3	none	none
	SUS	2.58	none	none

Adhesive Transfer after heating at 150 C for 30min

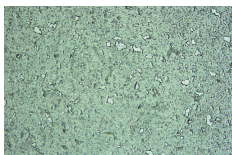
150°Cで加熱後の糊残り

Adherend : SUS
被着体 : SUS

THS 150°C
30min



6hr



Adhesive Transfer exist
糊残りあり

SHR 150°C
30min



6hr



Reliability

信頼性

Change in peel strength after applying to each adherend

各被着体と貼り合わせ後の粘着力の変化

Little increase in Peel Strength, in high temperature and humid condition.

高温や多湿の環境でも粘着力の上昇がほとんどありません

		High Temperature & Humidity 高温多湿 THS:65°C95%RH/SHR:60°C90%RH		High Temperature 高温 80°C	
[N/25mm]		0hr	500hr	0hr	500hr
THS	PET	0.072	0.076	0.072	0.101
	Glass	0.06	0.045	0.06	0.079
	SUS	0.035	0.086	0.035	2.254
SHR	PET	0.1	0.15	0.1	0.18
	Glass	0.08	0.08	0.08	0.09
	SUS	0.07	0.28	0.07	0.26

Caution : Adhesion transfer may occur with SUS after high temperature storage.

注意 : SUS等金属に貼りあわせて高温下で長時間経過した場合糊残りすることがあります。

The peel strength test values provided are measured by peeling conducted at 300mm/min and 180° from the Prosave side.(Based on JIS Z-0237)

粘着力試験は、プロセーブ側から300mm/min、180°で剥離した測定値です。(JIS Z-0237に準拠)

The table shows typical test results and does not guarantee material value.

いずれの値も任意のサンプルの測定値であり保証値ではありません。

All product specifications are subject to change without notice.

記載内容は断わりなく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

KIMOTO

Kimoto Co.,Ltd

✉ office030@kimoto.co.jp

http://www.kimoto.co.jp

株式会社 きもと

✉ office030@kimoto.co.jp

http://www.kimoto.co.jp

お問い合わせ先